



WAFER & GLASSUBSTRATE DICING GMBH & CO. KG:

EXPERTEN IM DICING & DIE-SORTING

Seit 22 Jahren bietet die Wafer & Glassubstrate Dicing GmbH & Co. KG Dienstleistungen rund um das Sägen in höchster Präzision. Der Kundenkreis setzt sich im Wesentlichen aus der optischen Industrie, der Halbleiter- und der Elektronikindustrie sowie der Automobil- und Raumfahrtindustrie zusammen.

Renommierete Unternehmen schätzen unser spezialisiertes Know-how, insbesondere wenn es darum geht, anspruchsvolle Anforderungen beim Sägen zu erfüllen, innovative Lösungen für Qualitätsprobleme zu finden oder Belastungsspitzen flexibel abzufedern.

Für viele kleine und mittelständische Unternehmen ist die WGDicing GmbH kompetenter Servicepartner für das hochpräzise und maßgeschneiderte Vereinzeln verschiedener Materialien wie Halbleiter, Gläser, technische Keramiken oder Leiterplatten. Dabei achten wir auf die Einhaltung vorgegebener Toleranzgrenzen und prüfen die Produkte hinsichtlich Qualität und kundenspezifischer Vorgaben.

Zusätzlich zum Dicing bieten wir unseren Kunden das Umverpacken der gesägten Bauteile an. Dafür stehen uns drei Pick-&-Place-Maschinen zur Verfügung. Die Bauteile können in standardisierte 2- und 4-Zoll-Trays, verschiedene Blistergurte oder andere Verpackungseinheiten umverpackt werden.

Frank Schön · Geschäftsführer

Wafer & Glassubstrate Dicing GmbH & Co. KG

Gewerbepark Birkenhain 26 · 63589 Linsengericht · Tel.: +49 6051 91678-0

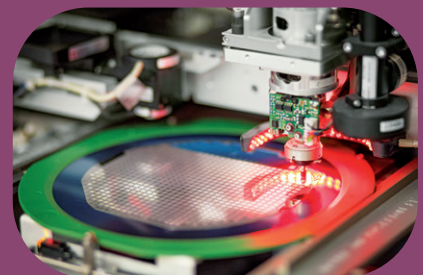
E-Mail: info@wgddicing.de · www.wgddicing.de



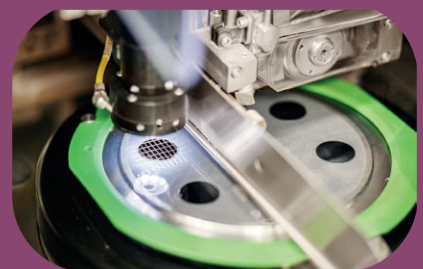
Unser Maschinenpark umfasst 13 halb- und vollautomatische 2 Zoll Wafersägen und 2 halbautomatische 4 Zoll Wafersägen.



Pick & Place Maschinen



Abpickprozess der vereinzelt Bauteile.



Sägeprozess